

論文分野とキーワード

分類		キーワード										
大分類	小分類											
1	材料技術	樹脂・有機材料	樹脂 接着剤	低誘電率材料 レジスト	誘電性ポリマー フィルム	熱硬化性樹脂 インク	熱可塑性樹脂 導電性ペースト	感光性樹脂 エポキシ・エポキシレジン	導電性高分子 ポリイミド	液晶 銅張積層板	封止材料 光ファイバ導波路	接合材料
		ガラス・セラミック材料	半導体 無機フィラー	磁性体 ペースト	圧電材料 保護膜	高誘電率材料 光ファイバ	低誘電率材料 層間絶縁膜	コンデンサ材料 複合基板	導電性セラミックス Pbフリー	結晶化ガラス	ガラス繊維	ガラスクロス
		金属材料	配線材料 金属微粒子	抵抗材料 メタルベース基板	磁性体 銅張基板	電極材料 ペースト	はんだ めっき	鉛フリーはんだ 腐食	リードフレーム材料 触媒	金属箔	銅箔	導電性フィラー
2	回路・実装設計／ 電磁特性技術	回路・実装設計技術	CAD CAE	配線パターン設計 チップ・パッケージ・ボード 協調設計	回路シミュレーション技術	接続実装設計 3次元実装設計	放熱実装設計 実装シミュレーション技術	半導体パッケージ設計 シグナル・インテグリティ設計	デジタル回路設計 パワー・インテグリティ設計	検査実装設計 平衡伝送/不平衡伝送	EMC実装設計	高速高周波実装設計
		電磁特性技術 (EMC/EMI)	高速・高周波伝送線路 EMCシミュレーション	高速・高周波特性シミュレーション EMCモデリング	高速・高周波特性測定・評価 エミッション	高速・高周波部品・材料 セパレビリティ	高速・高周波用パッケージ イムニティ	高速・高周波デバイス ESD (Electrostatic Discharge)	無線モジュール フィン	EMC測定評価 EMC用部品・材料	メタマテリアル 高周波材料測定・評価EMI	アンテナ実装 無線電力伝送
3	特性解析・評価技術	熱特性解析・評価技術	冷却技術 熱容量	放熱技術 定積比熱	熱伝導 黒体	放射 対流 熱暴走	ファン 過度温度上昇	ヒートシンク チップジャンクション温度	無線モジュール 熱回路網法	EMC測定評価 ヒートパイプ	熱抵抗 スプレッド・パラメータ定数	熱伝導率
		機械強度、構造、 応力解析評価技	変形 破断 せん断	応力 有限要素法	疲労 熱膨張係数	ひずみ そり ねじれ 膨張率	応力解析 コフィン・マンソンの式	脆性破壊 寿命 ヤング率	延性破壊 ボアソン比	弾性	靱性 き裂	クリープ
4	回路形成 ・配線板製造技術	めっき・エッチング 回路形成	パターン形成 露光・現像	成膜プロセス	真空成膜技術	メタライズ	アブレーション	サブトラクティブ	めっき	エッチング	表面処理	洗浄・前処理
		有機材料プロセス	多層配線板構造及びプロセス 穴あけ	多層化技術 ペースト	層間接続技術 ネットワーク	ビルドアップ レジスト	積層接着 各種マスク形成技術 (レジスト・フォトリソ等)	ラミネート モールド	樹脂硬化	印刷	塗布	研磨
		無機材料プロセス	多層配線板構造及びプロセス ドクターブレード	多層化技術 ミリング	層間接続技術 ガラスセラミック	焼結・焼成技術 穴あけ	印刷	セラミック	ガラス	ゾルゲル	ペースト	バインダ
		配線板および製造技術 一般	リジッド配線板	フレキシブル配線板	ビルドアップ配線板	複合配線板	インターポーサー/サブストレート	HTCC/LTCC	マルチベース/マルチコア			
5	信頼性解析技術	機械強度・構造信頼性	延性 熱応力/シミュレーション	疲労 膜応力	破壊 応力設計	き裂 熱応力設計	機械衝撃 熱解析	振動衝撃 クリープ	強度	靱性	応力解析/シミュレーション	寿命
		絶縁信頼性	短絡 ウイスカ	絶縁	マイグレーション	デンドライト	CAF	絶縁抵抗	耐電圧	耐湿性	寿命	電氣的寿命評価/シミュレーション
		接続信頼性	実装材料 クリープ	はんだ	金属間化合物	接合	拡散	疲労	応力	接触抵抗	接続抵抗	寿命
6	電子回路部品実装技術	電子部品技術	電子部品 薄膜素子	モジュール コンデンサ	高周波部品 抵抗	集積・複合部品 コイル	チップ部品 マイクロマシン	ビルドアップ配線板 フィルムキャリア	部品内蔵配線板	FPC	積層	厚膜素子
		接合・接続技術	表面実装	インターコネクション	ダイボンド	フリップチップ	ワイヤボンディング	TAB COB COC	COG COW COF	ゼブラゴム		
7	検査および装置技術	積層厚さ検査 実装板外観検査	穴形成・検査 実装板電気検査	めっき その他の検査	露光	配線板外観検査	配線板電気検査	内部検査	表面処理・検査	エッチング	パターン形成・検査	
8	光回路実装技術	光実装	光表面実装	光インタコネクション	光I/O	光モジュール	光部品	光集積	光ファイバー	光回路	光導波路	
9	環境調和型実装技術	廃棄物, 資源保護	リサイクル, プロセス改善	VOC, 代替物質	鉛フリー, 化学物質管理	ハロゲンフリー 環境分析・解析	省エネルギー 環境対応	効率改善 再生可能エネルギー	長寿命化	熱管理	資源削減	
10	半導体パッケージ・ モジュール技術	パッケージ	SOP/SOJ 信頼性/解析	QFP 設計	BGA/CSP	ワイヤボンディング TAB	リードフレーム	インターポーサー	ウエルベール	フリップチップ	ハンパ 樹脂	めっき 封止 (モールド)
		モジュール技術・SIP技術	MCM	ハイブリッドIC	3次元構造	スタック	信頼性/解析	設計				
11	マイクロメカトロニクス実装技術(MEMS)	MEMS実装 三次元加工	MEMS-CMOS集積化 エレクトロニクス	光MEMS実装 センサネットワーク	流体MEMS実装 ウェアラブルデバイス	マイクロエネルギー源 マイクロシステム融合	エネルギーハーベスト ヘテロ集積化	ウェアラブルデバイス	マイクロマシン	ナノインプリント	微細部品成型	
12	部品内蔵技術	ウェアラブルパッケージ	ビルドアップ	ガラスエポキシ基板	ベアチップ	薄型化	高機能モジュール	モバイル機器	三次元実装	IC内蔵	配線層	
13	プリンタブルデバイス実装技術	フレキシブル	ナノインク	電子ペーパー	ラジエリアレキシブルエレクトロニクス	カーボンナノチューブ	金属ナノワイヤ	転写印刷	グラビア	フレキシ印刷	インクジェット	
14	サーマルマネジメント技術	冷却技術 熱物性	放熱技術 マイクロナノスケール熱輸送	熱伝導	対流 データセンター	相変化	放射 温度予測	ファン 温度計測	ヒートシンク ハイブリッドエレクトロニクス	TIM	熱抵抗	